

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于聚辰半导体股份有限公司**  
**首次公开发行人民币普通股（A 股）的**  
**辅导工作进展报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已接受聚辰半导体股份有限公司（以下简称“聚辰半导体”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构。中金公司已与聚辰半导体签订了《聚辰半导体股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于 2018 年 11 月 23 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）提交了辅导备案申请。

自 2018 年 11 月 23 日向上海证监局提交辅导备案申请至本报告出具之日，聚辰半导体的拟申请上市交易所及板块发生变更，现将具体事项汇报如下：

聚辰半导体根据公司发展需要，为更好地促进公司未来业务发展，公司拟变更申请上市交易所及板块为上海证券交易所科创板。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告》之签署页)

